

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-08

投资者关系活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 现场参观 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 其他（<u>券商策略会</u>）
活动参与人员（排名不分先后）	财通证券、中邮证券、华泰证券、中信建投证券、万家基金、天弘基金、招银理财、嘉实基金、云禧基金、五矿证券、景鸿永泰投资、玄元投资、北京雪球私募、博时基金、广发资管、Millennium LP、APG、Point72
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2025 年 3 月 14 日
地点	电话及网络会议、华泰证券策略会举办地
形式	电话及网络会议、实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容：介绍公司 2024 年度经营业绩情况、问答交流。 一、公司 2024 年度经营业绩情况简介 2024 年，全球电子产业受益于 AI 带来的算力需求拉动以及周期性的库存回补，整体需求略有修复。在此背景下，公司紧抓算力与高速网络通信需求增长、汽车电动化/智能化趋势持续深化，以及通用服务器市场需求修复等机遇，加大各业务市场开发力度，推动产品结构优化，提升运营能力和生产经营效率，实现全年营收和利润的稳健增长。 报告期内，公司实现营业总收入 179.07 亿元，同比增长 32.39%；归母净利润 18.78 亿元，同比增长 34.29%；扣非归母净利润 17.40 亿元，同比增长 74.34%。其中，PCB 业务实现主营业务收入 104.94 亿元，同比增长 29.99%，占公司营业总收入的 58.60%；毛利率 31.62%，同比增加 5.07 个百分点。封装基板业务实现主营业务收入 31.71 亿元，同比增长 37.49%，占公司营业总收入的 17.71%；毛利率 18.15%，同比减少 5.72 个百分点。电子装联业务实现主营业务收入 28.23 亿元，同比增长 33.20%，占公司营业总收入的 15.76%；毛利率 14.40%，同比减少 0.26 个百分点。

二、主要交流内容

Q1、请介绍 2024 年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。

2024 年，PCB 业务实现主营业务收入 104.94 亿元，同比增长 29.99%；毛利率 31.62%，同比增加 5.07 个百分点。PCB 业务充分把握算力以及汽车电子市场的机遇，实现营收和利润的稳健增长。PCB 业务营收层面的增长贡献主要集中在集中在通信领域 400G 及以上的高速交换机、光模块产品需求增长；数据中心领域 AI 服务器及相关配套产品需求增长，以及服务器总体需求显著回温；汽车电子领域电动化/智能化趋势促进订单需求持续释放。

PCB 业务毛利率的增长得益于营收规模增加，PCB 工厂产能利用率提升，AI 相关领域订单需求增长助益 PCB 业务产品结构优化。同时，公司针对性开展多项运营管理能力提升工作，通过提升原材料利用率、前置引导客户设计、优化能源管理等多种方式强化成本竞争力，并针对部分瓶颈工序进行技术提效，保障高效产出，对 PCB 业务毛利率的提升起到正向作用。

Q2、请介绍 2024 年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。

2024 年，封装基板业务实现主营业务收入 31.71 亿元，同比增长 37.49%；毛利率 18.15%，同比减少 5.72 个百分点。封装基板业务在全球基板行业温和修复的环境下，加大市场拓展力度，加快推进新产品和新客户导入，推动订单较去年增长。封装基板业务毛利率的下降主要由于广州封装基板项目爬坡、金盐等部分原材料涨价，叠加下半年 BT 类基板市场需求波动、基板工厂产能利用率有所下降等因素共同影响。

Q3、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 产品方面取得的进展。

公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，18、20 层产品具备样品制造能力，各阶产品相关送样认证工作有序推进，20 层产品目前在客户端认证环节已取得比较良好的结果。

Q4、请介绍公司广州封装基板项目连线爬坡进展。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接包括 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡早期阶段，重点仍聚焦能力建设，由此带来的成本及费用增加，对公司利润造成一定负向影响。

Q5、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。

公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。其中，数据中心领域在 2024 年度成为公司 PCB 业务继通信领域之后，第二个达 20 亿元级订单规模的下游市场。

Q6、请介绍公司 2024 年度研发投入情况。

2024 年公司研发投入金额 12.72 亿元，占公司营收比重为 7.10%。公司各项研发项目进展顺利，下一代通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。

Q7、请介绍公司近期产能利用率情况。

公司 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率仍保持在高位运行；封装基板业务受近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率环比第四季度略有提升。

Q8、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q9、请介绍公司 PCB 业务在 PTFE 方面的布局情况。

PTFE 材料在高频 PCB 领域已有比较成熟的应用，公司在通信、汽车 ADAS 等高频应用场景已有相关成熟 PCB 产品。行业对 PTFE 在高速 PCB 领域的开发和大批量应用尚处在早期阶段，公司对行业前沿技术及应用保持关注与研究，已具有相应技术储备。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无